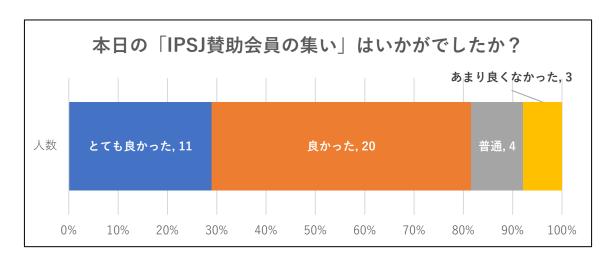
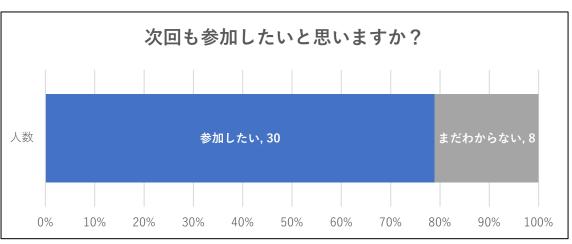
第9回IPSJ賛助企業との交流会 -GPU-開催レポート

• 開催日時:2024年4月17日(水)15時~17時

参加人数:78名、うちアンケートご回答数:38名





第9回 IPSJ賛助企業との交流会ーGPUー 【2024年4月17日(水)15-17時】

司会

情報処理学会 技術応用理事 小川 秀人(株式会社日立製作所)



オープニング 情報処理学会 副会長 松原 仁(東京大学)



講演1 牛木 威志 様(GDEPソリューションズ株式会社) 「心置き無くGPUを使いましょう! 水冷A100/H100デスクサイドシステム」

学会からのお知らせ 事務局長 木下 泰三



講演2 田中 数馬 様(スーパーマイクロ株式会社) 「進化するメモリ周辺技術とコンピューティングについて」



クロージング



2024年4月17日 第9回IPSJ賛助企業との交流会-GPU-

心置きなく GPUを使いましょう

水冷A100/H100デスクサイドシステム

GDEPソリューションズ株式会社 営業部 牛木威志





本日お話したいことは GPUのことで聞かれることの4点と1つ



- 1. CPUは万能だけど、GPUは万能ではありません
- 2. CPUとGPUの違いは?
- 3. ノード内マルチGPUでメモリ容量はふえない
- 4. GPUの違い(ゲーム用、ワークステーション用、サーバ用)

最後、GPUをオフィスでつかいましょう





GPUをデスクサイドで、ストレスなく使うには

そもそも、このようなものはありませんでしたので、多くの方が 「こんなのあったの?」という第一印象を持たれます

このシステムを用意した経緯・・・ サーバ用GPUやワークステーション用 高性能GPUを必要とする 親会社プロメテックソフトウェアからの要望が大きくあった

・静か、なるべく熱くならない

GPUの性能要望ではなく、周辺環境問題をお客様が持っていることを 解決する方法が必要となり、水冷(液冷)を開発検討

・GPUがフル稼働すると

通常、煩く、排熱は熱い (サーバ室であろうと場所は関係ない)





ご清聴ありがとうございました。

ご質問やお聞きになりたいことがありましたら、ご連絡を頂けれ ば対応をさせていただきます。

GDEPソリューションズ 牛木 ushiki@gdep-sol.co.jp

NVIDIA GPU デスクサイド水冷システム「AquSys」 https://gdep-sol.co.jp/gpu-products/a100qpu-water-cooling/



事業範囲

ビルディング・ブロック ソリューション

- マザーボード、I/O、シャーシ 電源、サーマルソリューション、 ファームウェア、BMC、セキュリ ティ、管理ソフトウェアを含む 大規模な最適化されたサブ
- 業界で最も広範な AI/サーバ ー/ストレージ/エッジ/IoT 製 品ホートフォリオを実現
- お客様のために市場投入まで 時間を迅速化



ラックスケール ソリューション

- ブラグアンドプレイ設計により 、お客様はネットワークと電 源を接続し、すぐにオンライン にすることが可能
- オンサイト導入と保守サービ
- 付加価値と競争力のある管 理、セキュリティソフトウェア



グリーン コンピューティング

- 高効率システム設計、フリー エア空冷/液休冷却
- 多くのお客様において、TCO を最大40%節約
- 業界全体でグリーンコンピュ ーティングを導入することによ り、年間100億ドルのエネル ギーコストを節約が可能に



オヘレーションや販売活動の 自動化により、あらゆる規模 の企業に効率的にサービス

ビジネス

オートメーション

24時間年中無休のセキュリ ティとサホートを提供するコマ





Supermicro 4.0

(Coming Soon)

グリーンコンピューティングの

システム/クラウドソフトウェ

ア/アブリケーション製品の充実

データセンター/クラウドi向け トータルソリューションの新機

能·新製品

SUPERMICE



www.supermicro.com

Supermicro GPU/AI Platforms



Highest Performance and Flexibility for AL/ML and HPC Applications

NVIDIA MGX







AMD MI300





Intel Max/ Gaudi





Why Liquid Cooling Air vs Liquid



Air Cooling Limitations

Poor Heat Transfer

- · More air flow required
- · More energy to cool hot air

Low Thermal Capacity

- · Lower temperature air required
- More air flow required
- · More chassis space required

Solution?

Liquid Cooling!



